

產學攜手合作專班

說 明 會



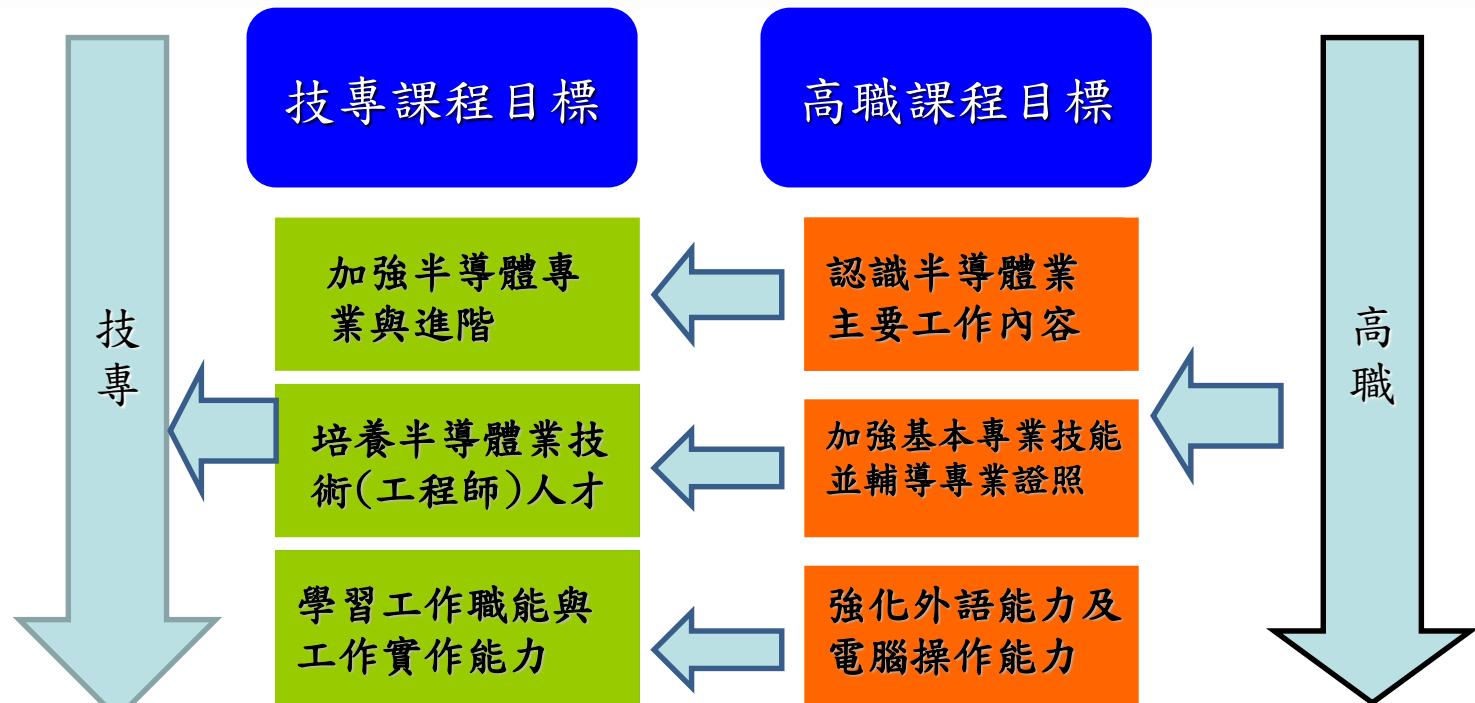
108.06.18

產學攜手合作計畫

目標

- (一)建立以兼顧就學就業為基礎之新教育模式。
- (二)發展技職縱向彈性銜接學制—學生學習一貫化。
- (三)提供經濟弱勢生優先就學機會，減輕負擔。
- (四)重理論與實務教學，彌補重點產業人才需求缺口。
- (五)建置業界與學校緊密教學實習合作平台，發揚技職教育「做中學、學中做」務實致用辦學特色。

高職端理論與實務並重



菱生精密工業股份有限公司

企業實習

技專端強調專精與進階

半導體產業

- 半導體產業簡稱IC(積體電路)產業，具有高度分工的特性，其製造、封裝與測試採分離作業方式進行
- 封裝與測試(簡稱封測)是屬於IC製造的後端作業程序。



產學攜手合作計畫--招生說明會

感謝家長熱烈的參與

實習主任詳細、親切的說明



產學攜手合作計畫--複試專業面談

勤益科大面試過程



廠商遴選過程



